

性能特点：

- 频带：8-12GHz
- 增益：26dB
- 饱和输出功率：30.5dBm
- 供电：Vgg:-1.2V；Vdd1、Vdd2、Vdd3：+5V
- 效率：40%
- 芯片尺寸：3.45mm×2.75mm×0.1mm

产品简介：

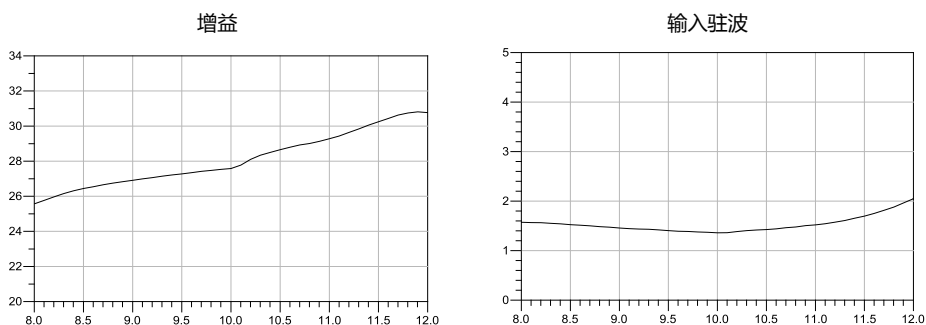
HH-PA0812 是一款 GaAs MMIC 功率放大器，其频率范围覆盖 8-12GHz，输出功率 30.5dBm，效率 40%。该芯片采用 Vg:-1.2V；Vd:+5V 供电。

电参数： (TA=25°C, Vgg=-1.2V, Vdd1=Vdd2=Vdd3=+5V)

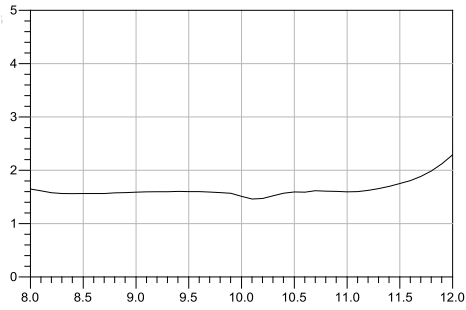
指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围		8-12		GHz
增益	-	26	-	dB
输入驻波	-	1.5	-	dB
输出驻波	-	1.8	-	dB
输出 P1dB	-	30.5	-	dBm
静态电流	-	250	-	mA
PAE	-	40	-	%

使用极限参数：

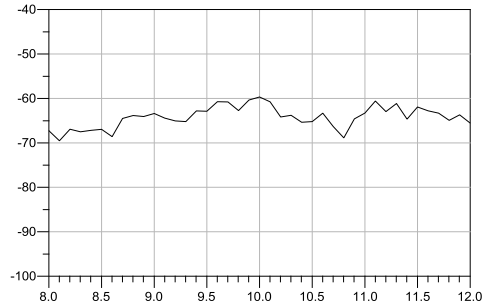
输入功率	23dBm
电压	+7V
存储温度	-65°C-150°C
使用温度	-55°C-85°C

典型曲线：


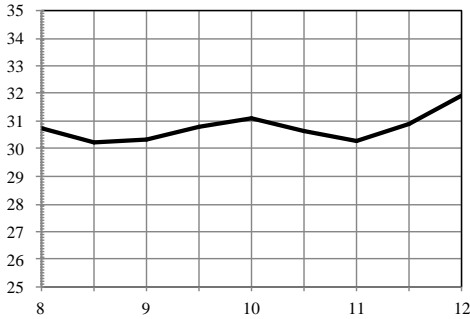
输出驻波



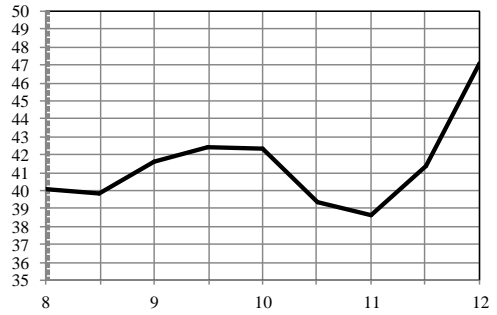
反向隔离



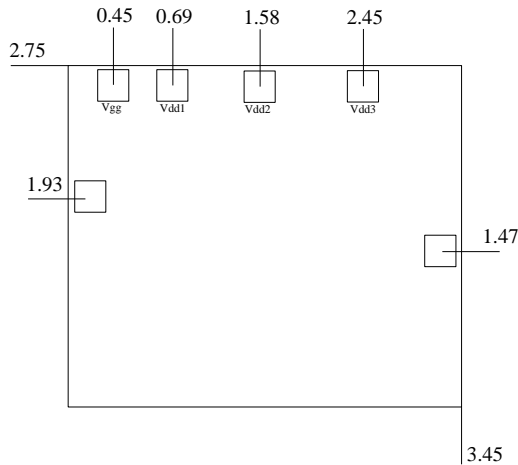
饱和输出功率



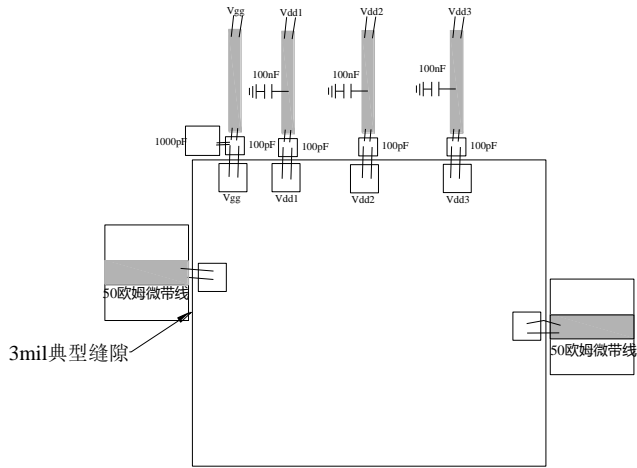
PAE



尺寸图 : (单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。